公司代码：688549　　公司简称：中巨芯

# 中巨芯科技股份有限公司
# 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中披露了可能面对的风险，提请投资者注意查阅。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

√是　□否

公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章 2.1.2 中规定的第（四）条：预计市值不低于人民币 30 亿元，且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。上市时，公司尚未实现盈利。

报告期内，公司归属于母公司所有者的净利润为 1,369.59 万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-956.83 万元。由于受市场竞争影响，部分产品销售单价出现下滑，导致销售毛利率下降；同时部分产品产生的营收仍较小，尚未实现规模效应，公司面临较高的折旧压力；且研发投入不断增大及公司经营不断扩大，管理成本有所上升；并叠加 2023 年确认 1,634.85 万元股份支付费用的影响，报告期内公司尚未实现盈利（扣除非经常性损益前后净利润孰低者）。

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润 13,695,857.25 元（合并报表），截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配的净利润为 36,763,405.00 元（合并报表）。公司母公司累计可供股东分配的利润为 59,385,106.86 元。

结合公司 2023 年的经营情况及 2024 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，本次公司利润分配预案为：拟以以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），以 2023 年年末总股本 147,727.60 万股计算，分红总金额为 14,772,760.00 元，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润全部结转至以后年度分配。

公司 2023 年年度利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通股（A 股） | 上海证券交易所科创板 | 中巨芯 | 688549 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 陈立峰 | 季灵杰 |
| 办公地址 | 浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道 247 号 2 幢 | 浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道 247 号 2 幢 |
| 电话 | 0570-3091960 | 0570-3091960 |
| 电子信箱 | Grandit_IR@grandit.com.cn | Grandit_IR@grandit.com.cn |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务情况

报告期内，公司专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。公司的产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节，是上述产业发展不可或缺的关键性材料。

2、主要产品情况

公司自设立以来专注于集成电路制造用电子化学材料，力争成为国内规模最大、品类最全、品质最高的电子化学材料提供商之一，为客户提供电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料等一站式服务。公司提供的主要产品如下表所示：

| 类别 | 产品名称 | 产品主要用途 |
|---|---|---|
| 电子湿化学品 | 1、通用电子湿化学品 | |
| | 电子级氢氟酸 | 刻蚀、清洗、玻璃减薄 |
| | 电子级硫酸 | 酸性清洗、刻蚀 |
| | 电子级硝酸 | 酸性清洗、刻蚀 |
| | 电子级盐酸 | 酸性清洗、刻蚀 |
| | 电子级氟化铵 | 缓冲氧化物刻蚀液原料 |
| | 电子级氨水 | 碱性清洗、氟化铵原料 |
| | 2、功能电子湿化学品 | |
| | 缓冲氧化物刻蚀液 | 缓释刻蚀 |
| | 硅刻蚀液 | 硅刻蚀 |
| 电子特种气体 | 1、刻蚀、清洗气体 | |
| | 高纯氯气 | 金属铝刻蚀、多晶硅刻蚀、光纤脱水 |
| | 高纯氯化氢 | 清洗、刻蚀 |
| | 高纯氟化氢 | 二氧化硅刻蚀、炉管清洗 |
| | 高纯氟碳类气体（主要包括三氟甲烷、六氟丁二烯、八氟环丁烷、八氟环戊烯等） | 刻蚀、清洗 |
| | 2、成膜气体 | |
| | 高纯六氟化钨 | 沉积集成电路内钨导电层 |
| 前驱体材料 | HCDS | 薄膜沉积 |
| | BDEAS | |
| | TDMAT | |

(二) 主要经营模式

1、盈利模式

报告期内，公司主要通过向下游集成电路、显示面板、光伏等领域的客户销售电子湿化学品和电子特种气体实现营业收入及利润。公司已建立了独立完整的研发、采购、生产、质量检测和产品销售体系，拥有成熟的盈利模式。公司目前主要采用“以销定产、订单驱动、合理库存”的生产经营模式，客户需求是公司生产经营的核心，研发、生产、销售、采购均围绕其展开。

2、研发模式

公司始终围绕自身的核心技术，公司以自主研发为主、合作研发为辅，搭建了以集成电路市场应用为导向、以产品创新及品质持续提升为驱动的研发模式。公司依托其“先进电子化学材料浙江省工程研究中心”开展研发活动，其中以中巨芯研发中心为主进行新产品开发，不断丰富产品品类；以各子公司研发团队为主进行工艺持续改进，以适应集成电路先进制程对电子化学材料品质持续提升的需求。

报告期内，公司通过持续、高效的研究工作，在落实国家重大科技专项、客户需求、内部研发项目的同时，实现了新产品的产业化，提升了产品的品质与技术水平，保证了公司研究成果与商业效益的相互转化。

公司制定了《研发项目计划管理规定》《研发项目验收管理规定》等制度，建立了研发管理内部控制流程，涵盖了公司及子公司研发计划、研发立项、执行监控、验收等环节。公司产品研发及产业化的流程主要包括项目论证、项目立项、项目实施、送样认证、成熟量产、持续改进等阶段。

3、采购模式

公司采购项目主要为产品生产、研发及项目建设过程所涉及的原料、机械设备、包装物等。相关工作主要由采购部负责。采购部门根据日常生产经营和研发项目等需求实施采购计划，根据采购计划向供应商下达订单。

报告期内，公司搭建了完整的采购体系，建立了标准化的采购制度，并实行了规范的采购控制程序。在供应商的选择方面，公司采购部门按照既定的标准和流程对供应商进行筛选；供应商资格进行预审后，对其生产条件、技术水平、质量保证能力、经营状况、供货能力、服务水平、准入类别等方面进行审核，经相关部门评审并报子公司总经理批准后纳入合格供应商目录，并对目录中的供应商采用日常考核和年度评价相结合的方式进行动态考评。

公司制定了《采购管理办法》《供应商管理办法》和《招投标管理办法》《合同管理办法》等制度，采购部通过组织比价、议价、谈判、招标方式选定供应商，签订合同。并协调合同履行，产品验收和入库，货款结算及售后跟踪等。确保货源供给充足，产品质量合格，采购过程规范，采购结果满意。

4、生产模式

公司的生产组织主要按照“以销定产、订单驱动、合理库存”的原则，围绕客户需求开展。销售部门每月汇总客户需求后，填写产品名称、规格、数量的清单，经销售部门负责人审核后，交由生产运营部。生产运营部会根据销售部门提供的客户产品需求清单，结合仓库库存情况，以及车间产能情况等制定生产计划表，交由制造部组织生产。报告期内，公司产品均自主生产，不存在外协、委托加工等情形。

5、销售模式

公司主要采用直接面向客户的直销模式，少量通过经销商进行销售。直销模式进一步分为非寄售模式和寄售模式，非寄售模式包括一般直销模式和代理模式，在该模式下，公司将客户所购买的产品交付至客户指定地点，接收人签收货物后，视同公司已经完成交付，公司根据签收单据确认收入，其中代理模式下，公司与代理商签订代理销售协议，由其负责向客户推广公司产品，公司根据销售量和实际交易价格向其按照合同约定结算佣金。报告期内通过代理模式形成销售的客户主要包括 SK 海力士、台湾 UMC 等，同时 SK 海力士（无锡）实现了氯气直销模式，实现代理和直销双重模式；寄售模式下，公司将货物发往客户的仓库，公司根据每月客户对账系统中的寄售产品领用情况确认收入。公司的经销模式为买断式经销，在将货物交付给经销商时确认控制权转移。公司在客户选择方面主要以集成电路、显示面板、光伏等领域的重点生产企业为主，并着力开拓具有较好市场前景和盈利能力的新应用领域。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所处行业发展阶段

公司处于电子信息与材料化工行业的交叉领域，属于典型的技术密集型行业，位于从基础化工材料到终端电子产品生产的产业链重要中间环节，是电子信息产业自主安全发展的关键支撑，对国内产业结构升级、国民经济发展具有重要意义，也是衡量一个国家科技进步的重要标志。公司产品主要包括电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料等半导体材料，主要应用于集成电路和显示面板制造领域。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”；根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“1 新一代信息技术产业——1.2 电子核心产业——1.2.3 高储能和关键电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）”；根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司产品属于“1 新一代信息技术产业——1.3 电子核心产业——1.3.1 集成电路——集成电路材料”。

① 电子湿化学品行业情况

根据中国电子材料行业协会数据，2022 年全球电子湿化学品市场规模（包括半导体、显示面板和光伏制造三大应用领域）为 639.1 亿元人民币，同比增长 6.64%。在半导体制造领域，根据 TECHCET 统计，2022 年，全球电子湿化学品市场规模在 42 亿美元左右，同比增长 6.7%，其中，通用电子湿化学品市场规模约 30.3 亿美元，配方型化学品市场规模约 11 亿美元。2023 年，受到全球半导体行业下行的影响，市场规模将同比出现小幅下滑。但从长期来看，受益于半导体制造产能的持续增长，全球电子湿化学品市场仍将保持增长势头，到 2027 年，市场规模将会达到 69 亿美元，2023-2027 年年均复合增长率达到 6%。

近年来，我国电子湿化学品市场规模快速增长。根据中国电子材料行业协会数据，2022 年，我国电子湿化学品整体市场规模约 176.7 亿人民币，其中，半导体市场约 56.9 亿人民币，显示面板市场约 64.0 亿人民币，光伏市场约 55.8 亿人民币，需求总计达 264.3 万吨。预计到 2025 年，我国电子湿化学品整体市场规模将达到 274.7 亿人民币，需求总量将增加至 460.5 万吨，2022-2025 年复合增长率为 15.84%，增速超过全球平均水平。

电子湿化学品是超大规模集成电路、平板显示、太阳能电池等制作过程中不可缺少的关键性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对生产、包装、运输及使用环境的洁净度都有极高要求。总体来看，目前全球电子湿化学品市场主要还是以欧美和日本企业为主，我国企业多年来不断积极研发，目前已取得一系列技术性突破，国产化率不断提升。

② 电子特种气体行业情况

根据 TECHCET 统计，在半导体制造领域，2022 年，全球电子气体市场规模约 68 亿美元，同比增长约 8%，预计到 2026 年，市场规模将达到 90 亿美元。市场增长的主要驱动力来自于电子特种气体营收的增长，电子特种气体市场占比超 70%，沉积、清洗、刻蚀和掺杂是电子特气的主要应用领域。2022 年，全球电子特种气体市场规模 48 亿美元，未来几年预计将保持较快增长，先进逻辑芯片、高端存储芯片是电子特种气体市场增长的主要驱动力。

随着国内半导体产业持续发展，我国电子特种气体市场增长速度高于全球增速。根据 SEMI 数据，2022 年，中国电子特气市场规模为 220.8 亿元人民币，预计 2025 年有望突破 300 亿元人民币，4 年 CAGR 约为 9.43%。在具体的下游应用中，集成电路及器件占比 44.2%、显示面板占比 34.7%、太阳能及 LED 等占比 21.1%。

电子气体是半导体晶圆制造材料中仅次于硅片的第二大细分材料市场，总体来看，目前主要由欧美和日本企业主导，国产化率不高。近年来，在政策与市场力量的不断推动下，国产部分产品逐步打破全球寡头垄断，自主可控背景下国产化有望加速。

③ 前驱体材料行业情况

前驱体材料是集成电路制造薄膜沉积工艺的核心材料。根据 TECHCET 统计，2022 年全球前驱体市场规模达 15.82 亿美元，同比增长 12%，行业整体增长强劲，主要得益于先进制程逻辑器件产量增加和 3DNAND 器件堆叠层数增加，DRAM 制造向 EUV 光刻的过渡也将带来前驱体收入增加的机会。未来，随着逻辑、存储芯片技术的持续发展，制程节点不断缩小、器件结构不断升级、存储 3D 堆叠层数不断增加，ALD 相关的前驱体材料应用会越来越多，前驱体材料总体市场规模将保持快速增长。

(2)行业基本特点

半导体材料处于整个半导体产业链的上游环节，是半导体产业的基石，起到了关键的支撑作用，是推动集成电路技术创新的引擎，素有“一代材料、一代技术、一代产业”的说法。半导体材料产业具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长、质量要求高、对环境洁净度要求苛刻、产品更新换代快、产品附加值高等特点。

(3)主要技术门槛

电子化学材料行业属于典型的技术密集型行业，研发周期长、研发投入大。由于部分关键材料直接决定了芯片性能和工艺发展方向，下游客户尤其是集成电路晶圆制造等半导体客户对产品品质、纯度、包装物、可靠性有着非常高的技术要求。在产品正式放量使用之前，需要经过长周期、多轮次的测试，而且上量的过程十分缓慢。与此同时，芯片产品更新换代速度快，电子化学材料生产企业需根据新产品的工艺特点和技术同步发展，以适应其工艺不断迭代的需要。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)电子湿化学品方面

凭借丰富的产品组合和优良的产品品质，公司已成为国内规模化生产电子湿化学品的主要企业之一，在国内率先具备为 12 英寸集成电路晶圆厂组合批量供应产品的能力，是国内少数能够稳定批量供应 12 英寸 1Xnm（10-20nm）制程集成电路制造用电子级氢氟酸，为 12 英寸先进制程稳定批量供应电子级硫酸，为逻辑芯片、存储芯片制造稳定批量供应电子级硝酸的企业。公司的电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等主要产品均已达到 12 英寸集成电路制造用标准，产品等级均达到 semi G5 级，均为中国集成电路材料产业技术创新联盟五星产品，产品质量达到国内同类先进水平，并在中芯国际、长江存储、华虹集团、SK 海力士、华润微电子、芯联集成等多家客户批量供货。公司的电子级氢氟酸被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国际先进且打破国际垄断”，电子级硫酸、电子级硝酸、电子级氨水和缓冲氧化物刻蚀液等四个产品均被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国内领先，打破国际垄断，实现重点领域降准替代且在知名用户应用”。

(2)电子特种气体和前驱体材料方面

在电子特种气体方面，公司承担了多项国家科技部重点研发项目，目前已实现 6N 纯度高纯氯气、6N 纯度高纯氯化氢、4N5 纯度六氟丁二烯、5N 纯度三氟甲烷、5N 纯度八氟环丁烷、4N 纯度八氟环戊烯和 5N5 纯度高纯六氟化钨量产，产品技术处于国内同类产品的领先水平，产品已在中芯国际、华润微电子、士兰微、厦门联芯、沪硅产业、河北普兴等多家客户通过认证并批量供货。公司高纯氯气、高纯氯化氢被浙江省经济和信息化厅认定达到“技术水平国内领先，打破国际垄断，实现重点领域降准替代且在知名用户应用”。

在前驱体材料方面，公司的 HCDS、TDMAT 产品实现量产销售，BDEAS 等产品成功送样，初步形成了集成电路制造用硅基、金属有机前驱体的开发能力，同时可以为客户提供定制化开发的服务，是国内少数能够进入该领域并完成产品生产的企业之一。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)新技术

在电子湿化学品方面，下游应用行业的未来发展趋势对电子湿化学品行业存在较大的影响。由于电子产业发展速度快、新产品的工艺特点和技术要求电子湿化学品与之同步发展，以适应其不断迭代的需要。以集成电路制造为例，集成电路性能与半导体制程紧密联系，应用于集成电路电子湿化学品的品控要求从 G3 级提升至 G4 级乃至 G5 级。

在电子特种气体方面，集成电路、显示面板、光伏、新能源汽车等下游应用领域产业技术快速更迭。例如晶圆尺寸从 6 英寸、8 英寸发展到 12 英寸，制程技术从 28nm 到 14nm 再到 7nm 以及以下；显示面板从 LCD 向 OLED 乃至柔性面板发展；光伏从晶体硅电池片向薄膜电池片发展等，电子特种气体作为这些产业发展的关键性材料，在气体纯度、混配精度等方面的技术要求将持续提高，如在先进制程的集成电路制造过程中，电子特种气体纯度要求通常在 5N 甚至 6N 以上。

在前驱体材料方面，薄膜沉积技术是集成电路制造过程中关键技术，而沉积不同材料的薄膜能够精确控制集成电路内部构造的成型，以实现不同的电气特性。涉及化学反应的薄膜沉积工艺主要分为化学气相沉积（CVD）和原子层沉积（ALD）等薄膜制备工艺。半导体前驱体材料根据形成薄膜的材料属性划分，可以分为硅基前驱体和金属基前驱体；根据集成电路晶圆制造工序划分，可分为高介电常数前驱体和低介电常数前驱体两类。随着集成电路制造工艺发展到 28nm 以下，高介电常数前驱体和低介电常数前驱体由于在不同制程模块中起到不可或缺的作用，将随着先进制程需求的提升得到大量应用。此外，14nm 及以下集成电路制程工艺中，鳍式场效应晶体管（FinFET）是重要的晶体管器件，其为 3D 结构，需要薄膜沉积工艺填充更小、更高纵深比的沟槽，因此 FinFET 工艺的应用对前驱体材料提出了新的要求。

(2)新产业

经济新常态下更加强调经济结构的优化升级，集成电路、显示面板、光伏、光纤光缆、新能源汽车等产业对中国经济增长的贡献率将愈加突出。电子湿化学品及电子特种气体、前驱体材料作为上述产业发展不可或缺的关键性电子化学材料，其市场规模将继续保持高速发展，国产化市场空间广阔。

(3)新业态和新模式

电子湿化学品、电子特种气体及前驱体材料行业竞争将逐步趋向于综合服务能力的竞争。具体情况如下：

在电子湿化学品方面，产品对纯度、洁净度要求很高，长途运输不利于产品品质，且运输成本高。一般情况下，电子湿化学品生产往往围绕下游制造业布局，减少运输距离，以确保产品品质、稳定供应，因此电子湿化学品需要考虑服务半径问题。

在电子特种气体方面，气体的产品种类丰富，且多数客户在其生产过程中对气体产品亦存在多样化需求。例如集成电路制造需要的特种气体种类超过 50 种，出于成本控制、仓储管理、供应稳定等多方面考虑，客户更希望能在一家供应商完成多种产品的采购，对气体公司所覆盖的产品种类提出了更全面的要求。另外，随着下游行业的产品精细化程度不断提高，客户所需的产品定制化特点明显，要求气体供应商能够根据其需求进行定制化生产，对气体供应商的技术与工艺水平提出了较高要求。此外，由于电子特种气体产品的特殊性，其使用过程中的包装物、管道以及供气系统的处理均会对最终使用的产品性能产生影响，因此客户更希望供应商能够提供电子特种气体包装物的处理、检测、维修，供气系统、洁净管道的建设、维护等全面的专业性增值服务。

在前驱体材料方面，NAND Flash 制造技术向 3D 技术发展，以适应小体积、大容量的市场需求，通过增加立体硅层的方式，既能提高单位面积存储密度，增加容量，又能改善存储单元性能，控制成本；在制造方面，与平面器件显著不同之处在于垂直集成放宽了对 3D NAND 器件的光刻要求，而是将最复杂的工艺挑战转移到沉积和刻蚀上，3D 结构中，需要进行几十层甚至上百层薄膜堆叠材料的生长，即随着堆叠层数逐渐增加，前驱体单位用量将翻倍增长，此时深宽比也不断加深，高深宽比孔道需要纵向和横向沉积单位价值量更高的高介电常数的前驱体等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减(%) | 2021 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,961,051,220.41 | 2,196,982,619.19 | 80.30 | 1,739,777,029.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,030,524,189.59 | 1,194,968,687.90 | 153.61 | 1,171,886,038.10 |
| 营业收入 | 894,015,891.56 | 798,995,814.03 | 11.89 | 565,795,608.47 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 821,176,300.58 | 734,068,315.09 | 11.87 | 537,492,113.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,695,857.25 | 10,522,262.12 | 30.16 | 33,320,264.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,568,345.20 | -7,322,358.12 | 不适用 | -6,821,642.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,019,333.38 | 101,589,819.54 | -0.56 | 36,376,499.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.82 | 0.89 | 减少 0.07 个百分点 | 2.96 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 7.12 | 7.47 | 减少 0.35 个百分点 | 7.1 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3 月份） | 第二季度（4-6 月份） | 第三季度（7-9 月份） | 第四季度（10-12 月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 204,867,819.40 | 208,910,202.59 | 234,909,462.97 | 245,328,406.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,252,261.20 | 20,268,658.04 | 9,218,128.13 | -14,538,667.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,539,678.81 | 3,716,616.29 | 6,985,782.99 | -16,731,065.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,427,983.62 | 88,672,370.45 | -21,564,707.24 | -9,516,313.45 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 48,181 |
|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 45,078 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况

| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 浙江巨化股份有限公司 | 0 | 390,000,000 | 26.3999 | 390,000,000 | | 无 | 0 | 国有法人 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 0 | 390,000,000 | 26.3999 | 390,000,000 | | 无 | 0 | 国有法人 |
| 衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 107,957,000 | 7.3078 | 107,957,000 | | 质押 | 87,269,201 | 其他 |
| 深圳市远致富海投资管理有限公司-深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙） | 0 | 100,000,000 | 6.7692 | 100,000,000 | | 无 | 0 | 其他 |
| 衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司 | 0 | 80,000,000 | 5.4154 | 80,000,000 | | 无 | 0 | 国有法人 |
| 厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 20,000,000 | 1.3538 | 20,000,000 | | 无 | 0 | 其他 |
| 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司-上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙） | 0 | 20,000,000 | 1.3538 | 20,000,000 | | 无 | 0 | 其他 |
| 中国保险投资基金（有限合伙） | 0 | 11,583,011 | 0.7841 | 11,583,011 | | 无 | 0 | 其他 |
| 中电科投资控股有限公司 | 0 | 11,583,011 | 0.7841 | 11,583,011 | | 无 | 0 | 国有法人 |
| 海通创新证券投资有限公司 | 0 | 11,583,011 | 0.7841 | 11,583,011 | | 无 | 0 | 国有法人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江巨化股份有限公司为厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人，国家集成电路产业投资基金股份有限公司为上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）有限合伙人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 89,401.58 万元，同比增长 11.89%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,369.85 万元，同比增长 30.16%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-956.83 万元。报告期末，公司总资产 396,105.12 万元，较报告期期初增长 80.30%；归属于母公司的所有者权益 303,052.41 万元，较报告期期初增长 153.61%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688549　　证券简称：中巨芯　　公告编号：2024-009

# 中巨芯科技股份有限公司
# 关于向参股公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中巨芯”）拟与徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛芯基金”）、宁波云德半导体材料有限公司（以下简称“云德半导体”）共同以现金方式合计向参股公司晶恒希道（上海）科技有限公司（以下简称“晶恒希道”）增资 11,300.00 万元，其中公司拟增资 4,520.00 万元认缴新增注册资本 4,520.00 万元，盛芯基金拟增资 3,390.00 万元认缴新增注册资本 3,390.00 万元，云德半导体拟增资 3,390.00 万元认缴新增注册资本 3,390.00 万元。本次增资后，公司与盛芯基金、云德半导体分别持有晶恒希道的股权比例保持不变。

● 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次关联交易已经公司第一届董事会独立董事第一次专门会议、第一届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事陈刚、吴桂芳回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

● 相关风险提示：

1、本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性；

2、在未来经营中，晶恒希道面临宏观经济环境、行业政策调整、市场需求变化等不确定因素影响，可能存在一定经营风险，无法实现投资预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、增资暨关联交易概述

为更好地实施公司战略规划及支持晶恒希道的业务发展，中巨芯拟与盛芯基金、云德半导体共同以现金方式合计向晶恒希道增资 11,300.00 万元，其中公司拟增资 4,520.00 万元认缴新增注册资本 4,520.00 万元，盛芯基金拟增资 3,390.00 万元认缴新增注册资本 3,390.00 万元，云德半导体拟增资 3,390.00 万元认缴新增注册资本 3,390.00 万元。本次增资后，公司与盛芯基金、云德半导体分别持有晶恒希道的股权比例保持不变。

晶恒希道是公司的参股公司，因公司董事、总经理陈刚担任晶恒希道董事长、公司董事吴桂芳担任晶恒希道董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，晶恒希道为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计总资产 1%以上，本次关联交易尚需提交股东大会审议。

二、增资标的暨关联方基本情况

(一)增资标的基本情况

| 公司名称 | 晶恒希道(上海)科技有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91310115MADBX4TF95 |
| 类型 | 其他有限责任公司 |
| 法定代表人 | 陈刚 |
| 注册资本 | 2,000 万元人民币 |
| 成立日期 | 2024 年 1 月 30 日 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 899 号 7 幢 3 层 302 室 |
| 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术玻璃制品销售；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |

(二)关联关系说明

公司董事、总经理陈刚担任晶恒希道董事长，公司董事吴桂芳担任晶恒希道董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，晶恒希道为公司关联方，构成关联关系。

(三) 业务情况说明

晶恒希道重点聚焦于半导体材料领域，致力于半导体材料相关的新产品、新技术、新工艺的研究与开发以及半导体材料领域的投资布局。

(四)主要财务数据

晶恒希道成立未满一年，尚无最近一年会计年度主要财务数据。

(五)本次增资前后晶恒希道的股权结构

| 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 认缴注册资本(万元) | 持股比例(%) | 认缴注册资本(万元) | 持股比例(%) |
| 中巨芯科技股份有限公司 | 800 | 40 | 5,320 | 40 |
| 宁波云德半导体材料有限公司 | 600 | 30 | 3,990 | 30 |
| 徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 600 | 30 | 3,990 | 30 |
| 合计 | 2,000 | 100 | 13,300 | 100 |

(六)增资标的权属情况说明

晶恒希道股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

经查询，晶恒希道不是失信被执行人。

三、关联交易定价

本次增资系经各股东协商一致，充分考虑晶恒希道业务发展需求，按照各自原持股比例以每股 1 元价格同比例增资。本次交易价格客观、公允、合理，符合国家有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、拟签署增资协议的主要内容

目前尚未签订具体协议，具体内容以实际签署协议为准。

五、本次增资暨关联交易的必要性以及对公司的影响

晶恒希道重点聚焦于半导体材料领域，致力于半导体材料相关的新产品、新技术、新工艺的研究与开发以及半导体材料领域的投资布局。

本次增资系根据晶恒希道业务发展的需要，进一步推动公司半导体材料业务的拓展，符合公司战略发展需要，有利于提升公司的竞争力和影响力，促进公司可持续发展。

本次关联交易不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、风险提示

1、本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不确定性；

2、在未来经营中，晶恒希道面临宏观经济环境、行业政策调整、市场需求变化等不确定因素影响，可能存在一定经营风险，无法实现投资预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

七、本次交易的审议程序

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，全体独立董事均表决同意，认为本次增资交易有利于进一步推动公司半导体材料业务的拓展和提升公司的综合实力，符合公司战略发展需要，同意将本次交易事项提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。公司于 2024 年 3 月 26 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，其中关联董事陈刚、吴桂芳回避表决，其余董事均表决同意。

此项交易尚需获得股东大会的批准。本次关联交易无需经过有关部门批准。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为，本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事召开了专门会议并发表了明确的审查意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易将进一步推动公司半导体材料业务的拓展，符合公司战略发展需要，有利于提升公司的竞争力和影响力，促进公司可持续发展。本次关联交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，没有损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次向参股公司增资暨关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

证券代码：688549　　证券简称：中巨芯　　公告编号：2024-010

# 中巨芯科技股份有限公司
# 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 4 月 22 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 22 日　　14 点 00 分

召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日

至 2024 年 4 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，